บรรณานุกรม

กานดา พูนลาภทวี, 2539. “สถิติเพื่อการวิจัย” การคำณวนขนาดตัวอย่าง, หน้า 130-145

กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชย์, และคณะ, 2545. “การปรับปรุงคุณภาพโดยระบบ ซิกส์ซิกม่า” วารสารการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี, หน้า 990-997

ณัฐพนธ์ เขจรนันท์, 2545 . “คู่มือปฏิบัติ ซิกส์ซิกม่า เพื่อสร้างความเป็นเลิศในองค์กร” พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์บี ไปร์ดบุ๊ค

ดร.วิทยา สุหฤทดำรง, และคณะ , 2545, “Six Sigma กลยุทธ์การจัดการระดับโลก ” กระบวนการซิกส์ซิกม่า, หน้า 32-36.

บรรเลง ศรนิล. 2548. “เทคโนโลยีพลาสติก” พิมพ์ครั้งที่18, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ

ปรเมศ ชุติมา. 2545. “การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม” สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ

พิชิต สุขเจริญ, 2521. “การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม” ความสามารถของกระบวนการ , หน้า 231

ยุทธ ไกยวรรณ์. 2536. “สถิติเพื่อการวิจัย”. ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. กรุงเทพ ฯ.

Advanced Plastic Inc., 2003. “Warpage Analysis of 50 – position Connector”, www.robustmolding.com/warpage.htm

Articles form CALCE new ,2004. “Effect of Flip-chip Package Warpage on thermal interface”:3-6

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

บรรณานุกรม (ต่อ)

Adam Kramschuster, et al,2005. “Quantitative study of Shrinkage and Warpage Behavior for microcellular and convention injection molding”: 1409-1413

Blanton Godfrey , Dean and Dr. Timothy G.Clap, 1997. “Design for Six Sigma versus Traditional New Product Development” Journal of Textile and Apparel: 27-35.

Bingfeng F., et al., 2003. “Warpage Prediction of Optical Media”: 865-871

Breyfogle, W.F, 1992. “Statistical Methods for Testing Development, and Manufacturing”. John Wiley & Sons, INC. New York United States of America.

Brian Diames, 2006. “Flex Circuit Basics Training Module1” Terms , Definitions and Important concept : 5-12

D. Chen, et al., 2006 “Plastic rubber and composites” : Effect of processing condition on shrinkage and warpage and morphology of injection molded parts using microcellular injection molding: Abstract.

Electronic packaging Technology Conference,1997. “FEA Application in DOE and design optimization”: 177-182

Forrest W. Breyfogle III Jame M. Cupeelo and Becki Meadows ,1946 . “Managing Six Sigma” A wiley-Interscience Publication.

Forrest W. Breyfogle III, James M. Cupello , Becki Meadows .1946 . “Managing Six Sigma” : 25-36

G. Chen, et al., 2004. “EMC characterize and process study for electronics packaging”: 454-458

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

บรรณานุกรม (ต่อ)

Innovex, 2007 . “Flex circuit manufacturing Basis” Training material

Journal of Electronic package volum123 ,2001. “Thermal and Mechanical loading effect on the Reliability of Organic Flip Chip Package”: 83-87

Journal of Electronic Packaging Volum126 Issue2, 2004. “Warpage Analysis of Underfilled Wafer”: 265-270

J.G.J Beijer, et al.,2006. “Warpage minimization of the HVQFN map mould”

Mociga Training Material, 2005. “Innovex BB Training” Define and Measure Phase: 1-7

Robert V. White, 1992. “An Introduction to Six Sigma with a Design Example” IEEE : 28-35

Seagate ,2003. “Supplier Six Sigma modular Training” Material

Subir Chowdhury, 2001. “The Power of Six Sigma” 3-4

Wei Lin, et al. ,2006. “Control of Warpage on Package”

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved